

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-011

## 沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 自愿披露公司发布新产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 3 月 19 日在公司上海临港厂区竣工仪式现场发布前道单片式化学清洗机新品 KS-CM300，于 3 月 20 日至 22 日 SEMICON China 2024 上海国际半导体展会期间发布全自动 SiC 划片裂片一体机新品 KS-S200-2S1B。

● 上述新产品的发布将进一步丰富公司的产品矩阵，拓宽公司在半导体装备市场的业务空间，有助于巩固和提升公司核心竞争力，预计将对公司未来发展产生积极影响。

● 上述新产品目前尚未取得客户正式订单，存在未来市场推广与客户开拓不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

### 一、新产品基本情况

#### （一）前道单片式化学清洗机

##### 1、发布时间及地点

拟于 2024 年 3 月 19 日上午在上海市浦东新区飞渡路 1388 号芯源微临港厂区发布。

##### 2、产品简要介绍

该款机台由公司上海临港子公司自主研发，具有高工艺覆盖性、高稳定性、高洁净度、高产能、高智能化等多重优势，适用于薄膜前后的清洗、干法蚀刻后清洗、离子注入灰化后清洗、CMP 后清洗等多种清洗工艺，能够满足客户对于

UP Time、刻蚀一致性等稳定性指标的严苛要求。同时，机台还充分借鉴了公司在前道 Track 及 Scrubber 等领域的成熟技术，通过不断优化内部单元及整机设计，可有效确保机台内部微环境均匀稳定，并最大程度压缩 chamber 空间，推出的高产能架构能够助力客户实现清洗效率的显著提升。此外，机台还将配备多项智能化功能，实现 AI 赋能。

## （二）全自动 SiC 划片裂片一体机

### 1、发布时间及地点

拟于 2024 年 3 月 20 日至 22 日在上海新国际博览中心 SEMICON China 2024 展会 N3 馆-3201 发布。

### 2、产品简要介绍

该款机台由公司日本子公司与合作伙伴联合研发，主要适用于 6/8 寸 SiC 晶圆的切割及裂片工艺，同时应用范围可拓展至其他三五族化合物、陶瓷、蓝宝石等特种材料。该机台具有整机设计紧凑、配置灵活、高产能、干法切割、断面平整、无切口损失等特点，致力于为下游客户提供更加经济高效的特种材料切割方案。

## 二、新产品对公司的影响

公司是国内涂胶显影细分领域龙头，经过多年发展，产品已完整覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域，下游客户包括国内各大晶圆厂、封装厂及化合物半导体厂商。

本次推出的前道单片式化学清洗机新品，将有效弥补公司在前道单片式化学清洗领域的空白，实现“物理+化学”清洗双覆盖，为公司打造新的业绩增长点；推出的全自动 SiC 划片裂片一体机，将进一步丰富公司在小尺寸领域的产品布局，提升在小尺寸领域的综合竞争力。

未来，公司将继续基于国内领先的涂胶显影及湿法领域等相关技术储备，按照“整机+部件”双轮驱动战略，持续完善产品布局，推动自身健康可持续发展。

## 三、必要的风险提示

公司上述新产品目前尚未取得客户正式订单，后续将根据市场需求情况进行销售拓展，新产品的销售将受到未来市场需求、市场认可度、市场开拓力度及技术性能迭代等多方面因素的影响，存在未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

公司尚无法预测新产品对公司当前及未来经营业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2024年3月19日